# Berührungsloses Lokalisierungssystem Body Positioning System BPS5400 von SICK gewinnt AEE Innovation Award 2019

Waldkirch / Düsseldorf, im Juni 2019 – Gleich bei der ersten Teilnahme an der Automotive Engineering Exposition AEE in Nürnberg am 4. und 5. Juni 2019 belegt die SICK AG mit dem BPS5400, einem kameragestützten Lokalisierungssystem für Fahrzeugkarossen, den ersten Platz beim AEE Innovation Award 2019.

Mit dem innovativen Body Positioning System BPS-5400 hat SICK gemeinsam mit einem Kunden aus der Automobilindustrie ein innovatives System entwickelt und bietet neue Freiheitsgrade im Karosseriebau. Im Gegensatz zu konventionellen Positionier-Systemen basierend auf mechanischer Unterbauspanntechnik punktet die berührungslos arbeitende Komplettlösung von SICK mit mehr Flexibilität in der Fertigung, kürzeren Zykluszeiten, minimiertem Verschleiß sowie einem Höchstmaß an Energieeffizienz. Das BPS5400 bietet zudem alle Funktionalitäten für die Integration in Industrie 4.0-gerechte Fertigungsstrukturen – und damit eine hohe Investitions- und Zukunftssicherheit. „Mit unserem BPS-5400 wollen wir den Karosseriebau revolutionieren und gehen gleichzeitig einen weiteren Schritt in Richtung Industrie 4.0. Der Award bestätigt uns in unserem Vorhaben“, erklärt André Hack, Leiter Industry Cluster Automotive bei der SICK AG. „Vor allem vor dem Hintergrund der Elektrifizierung von Fahrzeugen, die andere Plattformen benötigen, jedoch auf der gleichen Linie gefertigt werden, bietet unser System mehr Flexibilität in der Produktion.“

Die Lösung von SICK hat sich hierfür aus Beiträgen von neun nominierten „Innovation Stars“ in der Abstimmung durch das Fachpublikum und den internationalen OEM-Beirat durchgesetzt. Prof. Christoph Wagener, Vorsitzender des OEM Beirats der AEE, hob in seiner Laudatio insbesondere den partnerschaftlichen Entwicklungsansatz des Systems hervor: „Der diesjährige Preisträger ist ein hervorragendes Beispiel für den Gründungsgedanken der AEE als ‚Plattform der Innovation‘, die hilft Fahrzeughersteller und Lieferanten enger miteinander zu verbinden.“

**BPS5400: berührungslose Lokalisierung statt mechanischer Zentrierung**

Das Lokalisierungssystem BPS5400 für Fahrzeugkarossen gewährleitet eine robuste und hochpräzise Vermessung der Karosserieposition. Die errechneten 3D-Positionskoordinaten ermöglichen eine prozesssichere, adaptive Roboterführung. Das BPS5400 ist in alle Steuerungswelten integrierbar und steht schlüsselfertig für verschiedene Arbeitsabstände und Sichtfeldbreiten zur Verfügung – es kann aber auch in vielfältiger Hinsicht kunden- und anwendungsspezifisch angepasst werden.

Mit Lokalisierungsraten von über 99,996 Prozent und möglichen Einsparungen bei den Zykluszeiten von fünf Prozent und mehr überzeugen die Leistungsdaten. Zudem wird der mechanische Verschleiß und Wartungsaufwand im Vergleich zu mechanischen-Lösungen mit Zentrierdornen nahezu eliminiert. Da bei der Lokalisierung mit dem BPS5400 im Gegensatz zu RPS kein Absenken des Skid-Liftes mehr erforderlich ist, können zudem signifikante Einsparungen bei den Energie- und Betriebskosten sowie eine Verbesserung der CO2-Bilanz erreicht werden. Auch in puncto Platzbedarf und Gewicht überzeugt das innovative Lokalisierungssystem von SICK – und eröffnet so mehr Freiheitsgrade bei der Auslegung von Roboterzellen oder der Installation auf erhöhten Förderebenen.

**Über den AEE Award**

Der AEE Award wird im Rahmen der AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPO (AEE) verliehen – 2019 zum zweiten Mal. Auf der Fachmesse für die Prozesskette Karosserie – vom Konzept zur Endmontage am 4. und 5. Juni 2019 waren neun Innovationen von Ausstellern nominiert. Die OEM- und Lieferantenbeiräte sowie Fachbesucher und Kongressteilnehmer stimmten ab und wählten die SICK AG, die Fronius Deutschland GmbH und die Sika Technology AG zu den Siegern 2019.

Bild: BPS5400  
*Das kameragestützte Karossen-Lokalisierungssystem BPS5400 bietet mehr Flexibilität in der Fertigung, verkürzt Zykluszeiten, minimiert Verschleiß und senkt die Betriebs- und Energiekosten.*

Bild: SICK\_AE-EXPO\_2019\_360

*Von links nach rechts: Michael Zeitler, André Hack (SICK AG), Ingo Schübel (SICK Vertriebsgesellschaft Deutschland - SVD), Thomas Stähler (SICK AG), Kai Fischer (SVD),*

Ansprechpartner

Melanie Jendro │PR Manager │melanie.jendro@sick.de

+49 7681 202-4183 │+49 151 741 035 31

SICK ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2018 beschäftigte SICK knapp 10.000 Mitarbeiter weltweit und erzielte einen Konzernumsatz von knapp 1,6 Mrd. Euro.

Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter http://www.sick.com.